

半导体晶圆激光切割晶态硅激光打孔精密刻槽支持定制

产品名称	半导体晶圆激光切割晶态硅激光打孔精密刻槽支持定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

激光切割晶圆，很好的避免了砂轮划片存在的问题。是通过将脉冲激光的单个脉冲通过光学整形，让其透过材料表面在材料内部聚焦，在焦点区域能量密度较高，形成多光子吸收非线性吸收效应，使得材料改性形成裂纹。每一个激光脉冲等距作用，形成等距的损伤即可在材料内部形成一个改质层。在改质层位置材料的分子键被破坏，材料的连接变的脆弱而易于分开。切割完成后通过拉伸承载膜的方式，将产品充分分开，并使得芯片与芯片之间产生间隙。这样的加工方式避免了机械的直接接触和纯水的冲洗造成的破坏。目前激光切割技术可应用于蓝宝石/玻璃/硅以及多种化合物半导体晶圆。

华诺激光****以及售后服务承诺：所有硅片激光切割产品在出货前均会经过严格专业的品质检验，确保发货到您手里的产品是合格产品。若客户对我司的产品提出质量异议，公司会在4小时内作出处理意见，若需现场解决，我司将派出专业技术人员及品质人员解决，不解决问题人员不撤离，对每次客户的质量问题及处理结果予以存档，以做培训和案例分析。

激光切割硅片应用行业：

半导体集成电路，包括单双台面玻璃钝化二极管晶圆切割划片，单双台面可控硅晶圆切割划片，砷化镓，氮化镓，IC晶圆切割划片。